



TECHNONICOL

PREMIUM



LOGICPIR

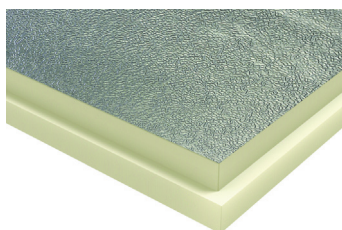
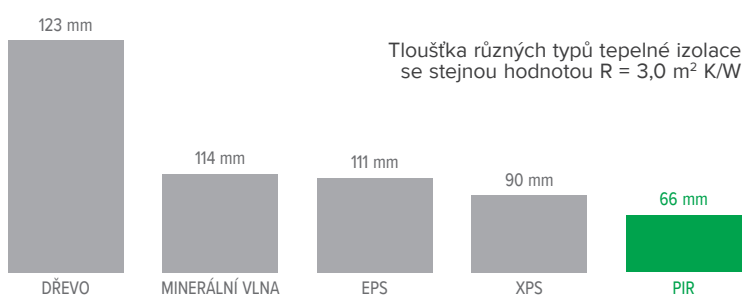
TEPELNÁ IZOLAČNÍ DESKA

LOGICPIR je deska vyrobená z tuhého PIR (polyisokyanurát) pro použití v plochých střešních systémech. Jde o velmi tuhý a dokonale plochý materiál, který je ideálním substrátem pro střešní krytiny, a to zejména pro syntetické membrány. LOGICPIR má vysokou pevnost v tlaku a velmi nízkou hodnotu tepelné vodivosti 0,022 W/m*K.

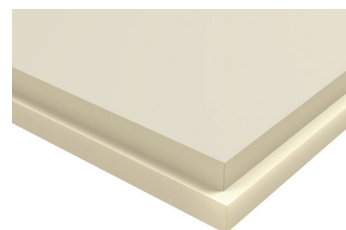
Více než 95 % materiálu PIR se skládá z uzavřených buněk. Deska PIR neabsorbuje vodu. Udrží stabilní parametry po dlouhou dobu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tloušťka, mm	20–250 v krocích po deseti
Velikosti desky, mm	1200 × 600, 2400 × 1200
Tepelná vodivost, W/m ² K	0,022
Reakce na oheň	Třída E
Tlaková síla, kPa	120
Dlouhodobá absorpce vody, %	1
Typ povrchu	Hliníková fólie nebo rohož ze skelných vláken



LOGICPIR s hliníkovým povrchem



LOGICPIR s rohoží ze skelných vláken

UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI LOGICPIR



SPOLEHLIVOST A TRVANLIVOST

Po celou dobu své 25leté životnosti si LOGICPIR zachovává své vlastnosti. Účinně plní svou funkci v teplotním rozmezí od $-65\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+110\text{ }^{\circ}\text{C}$, proto je vhodný pro použití v každém klimatickém prostředí.



NEABSORBUJE VODU

Struktura desky je tvořena uzavřenými tuhými buňkami, které neumožňují vodě proniknout do materiálu. Kompozitní vrstvy, vyrobené z hliníkové fólie a plastu, poskytují dodatečnou izolaci proti výparům.



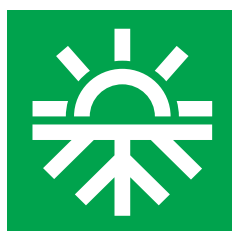
NEHOŘÍ

LOGICPIR není hořlavý. Při kontaktu s otevřeným ohněm hoří polymer pouze na povrchu. To vytváří povrchovou vrstvu dřevěného uhlí, která je účinnou obranou proti dalšímu poškození polymeru.



ODOLNOST PROTI DYNAMICKÉ ZÁTĚŽI

LOGICPIR vyhovuje třídě 2 pro dynamické zatížení (EN 826). Pevnost v tlaku 120 kPa poskytuje vysokou odolnost proti deformaci v důsledku živého zatížení.



REKORDNĚ NÍZKÁ TEPELNÁ VODIVOST

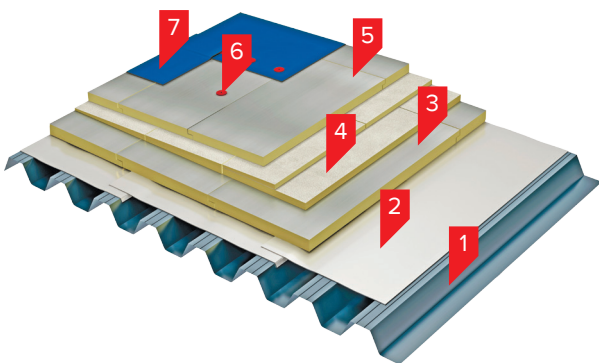
LOGICPIR má velmi nízkou tepelnou vodivost $0,022\text{ W/m}\cdot\text{K}$. Desky mají okraje tvarované do L, takže vzájemně pevně přiléhají a tím zabraňují tepelným mostům.



NÍZKÁ HUSTOTA

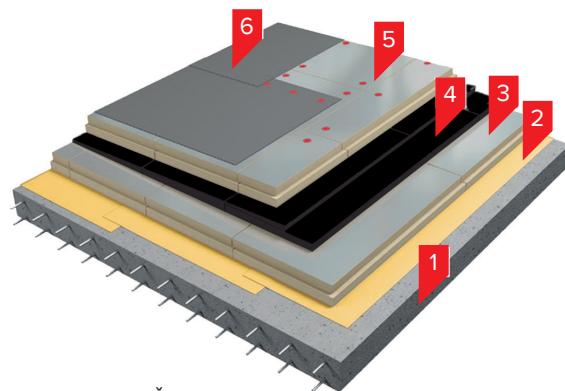
Nízká hustota LOGICPIR je kombinována s vysokou tepelnou odolností. Použití tohoto produktu snižuje celkovou váhu střechy. To je důležité zejména při rekonstrukci střech. Dopravní náklady jsou rovněž podstatně sníženy.

STŘEŠNÍ SYSTÉMY



MECHANICKY UPEVNĚNÝ STŘEŠNÍ SYSTÉM

1. Vlnitý ocelový plech
2. Parotěsná zábrana
3. Tepelná izolační deska LOGICPIR
4. Tepelná izolační deska LOGICPIR Slope
5. Tepelná izolační deska LOGICPIR
6. Mechanické připevnění
7. Membrána LOGICROOF V-RP



RENOVACE STŘECHY

1. Železobetonová základna
2. Parotěsná zábrana
3. Tepelná izolace
4. Bituminózní membrána
5. Tepelná izolační deska LOGICPIR
6. Membrána LOGICROOF V-RP

